



中华人民共和国国家标准

GB/T 34507—2017

封装键合用镀钯铜丝

Palladium coated copper bonding wire for semiconductor package

2017-10-14 发布

2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准起草单位:北京达博有色金属焊料有限责任公司、山东科大鼎新电子科技有限公司、有色金属技术经济研究院、浙江佳博科技股份有限公司、广东佳博电子科技有限公司。

本标准主要起草人:闫茹、向翠华、向磊、李天祥、赵义东、周钢、周晓光、刘洁、高亮、梁忠、孙妮。

封装键合用镀钯铜丝

1 范围

本标准规定了半导体封装包括分立器件、集成电路、LED 封装用镀钯铜丝的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书、订货单(或合同)。

本标准适用于半导体封装用镀钯铜丝。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5121.27 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 10573 有色金属细丝拉伸试验方法

YS/T 716.7 黑铜化学分析方法 第 7 部分:铂量和钯量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法和火焰原子吸收光谱法

3 要求

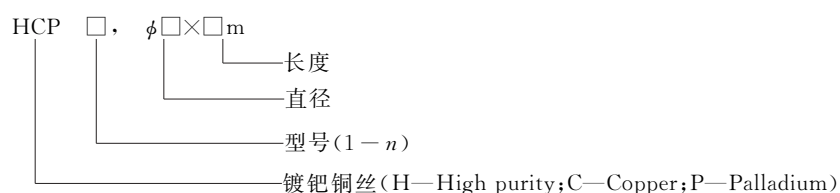
3.1 产品分类

产品的型号、状态、直径应符合表 1 的规定。

表 1

型号	状态	直径/mm
HCP1-n	半硬态	0.013,0.015,0.016,0.017,0.018,0.019,0.020,0.021,0.022,0.023,0.024,0.025,0.028,0.030,0.032,0.033,0.035,0.038,0.040,0.042,0.043,0.044,0.045,0.050
注 1: 可根据需方要求生产其他直径的产品。 注 2: 各生产厂家可根据不同的化学成分自行分配型号。		

3.2 产品标记示例



直径以毫米为单位标记。